

# NAGOYA NXI-37003DX 线自动检查机



Nagoya 名古屋 NXI-3700 半导体级 3DX 线超高解析度自动检查机特点简介：

- 自动检查功能 Through hole 中铜电镀检查 C4 焊锡球检查
- 开放型纳米焦点 X 线管 管电压:20kV-160kV 最小分辨率：0.25μm
- FPD 600 万像素/1.1.800 万像素 分辨率：0.25 μm-10μm/0.25-23.5μm
- 倾斜式 CT 方式

Nagoya 名古屋 NXI-3700 半导体级 3DX 线超高解析度自动检查机规格参数：

| 项目     | 参数                  |
|--------|---------------------|
| 对应工件尺寸 | W50×L50~W515×L610mm |
| 检查工件领域 | W475×L570mm         |
| 对应工件厚度 | 0.1-0.3mm           |
| 对应工件重量 | 2.0kg 以下            |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 部品高度   | 基板上 40mm                               |
| X 线发生管 | 开放型纳米焦点                                |
| 管电压    | 20-160kv                               |
| 管电流    | 0-200 $\mu$ A                          |
| 最小分辨率  | 0.25 $\mu$ m                           |
| X 线检出器 | 垂直：FPD 600 万像素/倾斜：1.1.800 万像素          |
| 分辨率    | 垂直：0.25-10 $\mu$ m/倾斜：0.25-2.5 $\mu$ m |
| 空气压力   | 0.5MPa                                 |
| 电源电压   | AC 220V $\pm$ 10%，单相 50/60Hz           |
| 消费电压   | 10kVA 以下                               |
| 使用环境条件 |                                        |
| 周围温度   | 22°C $\pm$ 2°C                         |
| 湿度     | 50% $\pm$ 10%RH（无结露）                   |
| 床振动    | 振幅 2 $\mu$ m 以下                        |
| X 线泄露量 | 低于 0.5 $\mu$ Sv/h                      |
| 外形尺寸   | W1780xD2530xH2000mm                    |
| 重量     | 约 7500kg                               |

### **Nagoya 在线型 3DX 线自动检查设备 NXI-3700 可选功能**

- 通过系统传输获得 PC 自动检查时所获取断层图片，对于不良部品可以进行确认并编辑
- 3D 合成软件可对 X 线的断层图片进行编辑并合成

### **NXI-3700 堪称世界最高等级性能 3D CT X-ray**

超高性能装置配合独自软件实现最高境界影像

纳米级 X 线管（最小分辨率：0.25 $\mu$ m）配合高感度 1.1.检查器（分辨率：0.25-2.5 $\mu$ m），高画质，无与伦比

配合全新图像变化率软件，获取独一无二 X 线图像

### **NXI-3700 采用高重复测试精度确保数据准确**

全新设计刚性结构配合高精度线性电机，配合全效补充软件，满足高速度，广范围移动定位精度

独自本体气囊设计，有效避免外界影响，实现世界最高等级重复测试精度

### **NXI-3700 可对应大型基板**

独有倾斜式 CT 机构，配合 515×610mm 大型基板，可以满足任意位置 CT 扫描需求

检测台上另附带真空吸附功能，满足最大 100μm 包括柔性基板在内安全定位，保证有效精确 CT 扫描

### **高精度高安定性自动检查系统**

独自开发自动校正系统，自动高度检查补正逻辑,YXZ 补正逻辑实现避免检测中的误差，还原真实影像，实现最高等级精度检测，满足半导体业界需求

### **Though hole 中铜电镀检查**

对于基板中通孔（Though hole,TH）中铜电镀及充填状况进行自动确认。数 μm 的 void 缺陷亦可自动检出

**C4 焊锡球检查** 通过对断层图像予以解析，自动识别焊接状况，锡球形状及 void 等不良